

日清エンジニアリング 「JAPAN PACK 2022[日本包装産業展]」に出展 ～工場・生産設備のエンジニアリング力をアピール～

日清製粉グループの日清エンジニアリング株式会社（社長：村田 博）は、2022年2月15日（火）～2月18日（金）の4日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催される「JAPAN PACK 2022[日本包装産業展]」に出展します。

■ 当社出展内容（ブース番号：西1ホール W1-P01）

当社ブースでは、食品や粉体等を取り扱う工場・生産設備のトータルエンジニアリングを提案します。粉体ハンドリング技術として、少量多品種生産に適したバッチ連続システムである「マトコン・コンテナ（IBC）システム」などをご紹介します。



<ブースイメージ>

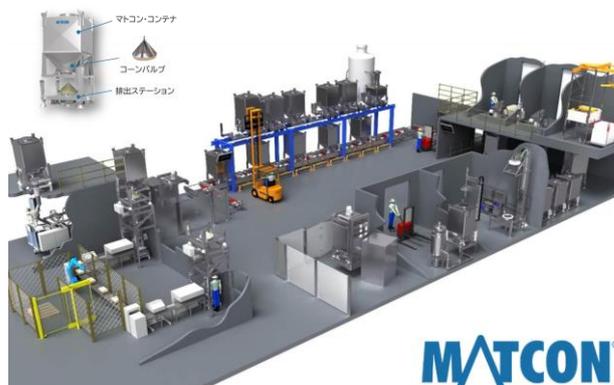
<<主な出展内容>>

■ マトコン・コンテナ（IBC）システム

IBC（中間バルクコンテナ）を用いた少量多品種生産に適したバッチ連続システムです。

当社が2002年から英国マトコン社のエンジニアリング・パートナーとしてお客様へ導入させていただいており、これまで食品・医薬のみならず、化学、金属粉体や電子・電池材料粉体など、幅広い分野で採用されています。

コンタミネーションのリスクを低減し、少量多品種生産を効率化するコンテナシステムです。



<マトコン・コンテナ（IBC）システム>

■ 食品・粉体工場トータルエンジニアリング

工場建設や生産設備施工のプロジェクトについて、トータルエンジニアリングの視点から進め方・取り組み方のポイントをご紹介します。また当社の豊富な実績の一部を展示します。

■ JAPAN PACK 2022[日本包装産業展]概要

JAPAN PACK（ジャパンパック）は、包装業界および関連業界における国内外の最新鋭機器・技術・サービスとそのユーザー・バイヤーが一堂に会する、2年に一度の大型商談展示会です。今年のカネテーマ『ともにつくる 未来の包程式』のもと、包装及び関連産業の最新機器・技術を公開します。バリューチェーンで全体最適を実現する「包程式」が、あらゆる生活必需品の生産から流通、消費、廃棄にわたる多種多様な課題を解決します。また、公式Webサイト内でオンライン形式でも開催されます。

- ・日 時：2022年2月15日（火）～2月18日（金）10：00～17：00
- ・会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）
西展示棟（1-4ホール）・南展示棟（1-2ホール）
- ・主 催：一般社団法人日本包装機械工業会
- ・開催テーマ：「ともにつくる 未来の包程式」
- ・公式Webサイト
： <https://japanpack.eventos.tokyo/web/portal/57/event/3972/>

以 上

この件に関する報道関係者のお問い合わせ先

株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 担当：神田・徳田
電話：03-5282-6650 （お問合せフォームは[こちら](#)）